

2011-2015年中国芯片设计 市场分析预测及投资方向研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2011-2015年中国芯片设计市场分析预测及投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201106/70218.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

9家芯片设计公司2009年的销售收入超过10多亿美元，领先的是高通和新进入这个市场的AMD。台湾的联发科技的销售收入达35亿美元，增长率为22%，是芯片设计公司中销售收入增长速度最快的。

高通2009年的销售收入接近66亿美元，增长了2%。10家最大的芯片设计公司(不包括AMD)2009年的销售收入下降了4%。其余的25大芯片设计公司的销售收入平均下降了13%。排名前10位的芯片设计公司2009年的市场份额达到了65%，比2007年提高了5%。美国的芯片设计公司继续占统治地位。在全球25家最大的芯片设计公司中，美国占17家。在10大芯片设计公司中，美国占7家。这个排行榜中只有一家日本公司。台湾地区和中國大陸的集成电路设计公司继续发展。IC Insights预计越来越多的台湾地区和中國大陸的芯片设计公司进入25家最大的芯片设计公司排行榜。

中国产业信息网发布的《2011-2015年中国芯片设计市场分析预测及投资方向研究报告》共十七章。首先介绍了中国芯片设计行业的概念，接着分析了中国芯片设计行业发展环境，然后对中国芯片设计行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国芯片行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国芯片设计行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业概述

一、芯片设计的定义

二、芯片设计的特性

第二节 行业界定

一、行业经济特性

二、细分市场概述

第三节 芯片设计行业发展成熟度分析

一、芯片设计行业发展周期分析

二、中外芯片设计市场成熟度对比

三、细分行业成熟度分析

第二章 国外芯片设计行业发展分析

第一节 全球芯片设计行业发展现状

一、2010-2011年全球芯片设计行业产业规模

二、2010-2011年全球芯片设计行业产业结构

第二节 全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节 主要国家和地区发展分析

一、2010-2011年美国芯片设计行业发展分析

二、2010-2011年日本芯片设计行业发展分析

三、2010-2011年台湾芯片设计行业发展分析

四、2010-2011年印度芯片设计行业发展分析

第四节 世界芯片设计行业发展现状分析

一、2010-2011年世界芯片设计行业发展规模分析

二、2010-2011年世界芯片设计行业发展特点分析

三、2010-2011年世界芯片设计行业竞争格局分析

第五节 2011年世界芯片设计行业发展形势分析

第六节 2011-2015年世界芯片技术发展趋势分析

一、小型化、高灵敏度

二、多功能趋势

三、芯片节能趋势

第三章 我国芯片设计行业发展现状

第一节 中国芯片设计行业现状

一、行业规模不断扩大

二、行业质量稳步提高

三、产品结构极大丰富

四、原材料与生产设备配套问题

第二节 芯片设计行业发展特点

一、产业持续快速发展

二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇

三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2010-2011年芯片设计行业发展分析

- 一、2010-2011年芯片设计行业经济指标分析
- 二、2010-2011年芯片设计业进出口贸易分析
- 三、2010-2011年行业盈利能力与成长性分析
- 四、2010-2011年芯片设计行业发展规模分析
- 五、2010-2011年芯片设计行业发展特点分析

第四节 中国芯片设计业存在的主要问题分析

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第四章 中国芯片设计市场运行分析

第一节 2010年中国芯片设计市场发展分析

- 一、2010年中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、2010年主要行业对芯片的需求统计分析
- 三、2011年中国芯片设计市场消费规模分析
- 四、2011年主要行业对芯片的需求分析预测

第二节 2010年中国芯片制造市场生产状况分析

- 一、2010年芯片的产量分析
- 二、2010年芯片的产能分析
- 三、2010年产品生产结构分析
- 四、2011年芯片的产量分析
- 五、2011年芯片的产能分析

第五章 芯片设计产品细分市场分析

第一节 2011年中国芯片细分市场发展趋势分析

- 一、生物芯片
- 二、通信芯片
- 三、显示芯片
- 四、数字电视芯片
- 五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

- 一、电子芯片市场结构

二、电子芯片市场特点

三、2011年电子芯片市场规模

四、2010年电子芯片市场分析

五、2011-2015年电子芯片市场预测

第三节 通讯芯片市场

一、通讯芯片市场结构

二、通讯芯片市场特点

三、2011年通讯芯片市场规模

四、2010年通讯芯片市场分析

五、2011-2015年通讯芯片市场预测

第四节 汽车芯片市场

一、汽车芯片市场结构

二、汽车芯片市场特点

三、2011年汽车芯片市场规模

四、2010年汽车芯片市场分析

五、2011-2015年汽车芯片市场预测

第五节 手机芯片市场

一、手机芯片市场结构

二、手机芯片市场特点

三、2011年手机芯片市场规模

四、2010年手机芯片市场分析

五、2011-2015年手机芯片市场预测

第六节 电视芯片市场

一、电视芯片市场结构

二、电视芯片市场特点

三、2011年电视芯片市场规模

四、2010年电视芯片市场分析

五、2011-2015年电视芯片市场预测

第六章 芯片设计产业发展地区比较

第一节 长三角地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第七章 芯片设计行业竞争格局分析

第一节 中国芯片设计行业结构分析

一、行业的省份分布概况

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

四、行业规模集中度分析

第二节 芯片设计业竞争格局分析

一、国际芯片设计行业的竞争状况

二、我国芯片设计业的国际竞争力

三、外资企业进入国内市场的影响

四、IC设计企业面临的挑战分析

第三节 我国芯片设计业的竞争现状

一、我国芯片设计企业间竞争状况

二、潜在进入者的竞争威胁

三、供应商与客户议价能力

第四节 2010-2011年芯片设计行业竞争格局分析

- 一、2010年国内外芯片设计竞争分析
- 二、2010年我国芯片设计市场竞争分析
- 三、2010年我国芯片设计市场集中度分析
- 四、2011年国内主要芯片设计企业动向

第八章 芯片设计企业竞争策略分析

第一节 芯片设计市场竞争策略分析

- 一、2011年芯片设计市场增长潜力分析
- 二、2011年芯片设计主要潜力品种分析
- 三、现有芯片设计产品竞争策略分析
- 四、潜力芯片设计品种竞争策略选择
- 五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 芯片设计企业竞争策略分析

- 一、金融危机对芯片设计行业竞争格局的影响
- 二、金融危机后芯片设计行业竞争格局的变化
- 三、2011-2015年我国芯片设计市场竞争趋势
- 四、2011-2015年芯片设计行业竞争格局展望
- 五、2011-2015年芯片设计行业竞争策略分析
- 六、2011-2015年芯片设计企业竞争策略分析

第十章 世界典型芯片设计企业竞争分析

第一节 高通（QUALCOMM）

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第二节 博通（BROADCOM）

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第三节 NVIDIA

- 一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第四节 新帝（SANDISK）

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第五节 AMD

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第十一章 芯片设计优势企业竞争分析

第一节 上海华虹

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第二节 中星微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第三节 中芯国际

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第四节 大唐微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第五节 其他优势企业

一、士兰微电子

二、有研硅谷

三、上海蓝光

四、扬州华夏

五、深圳方大

六、大连路美

七、台湾信越

八、台湾威盛电子

第十二章 芯片设计行业发展趋势分析

第一节 2011年发展环境展望

一、2011年宏观经济形势展望

二、2011年政策走势及其影响

三、2011年国际行业走势展望

第二节 2011年相关行业发展展望

一、2011年IC制造业展望

二、2011年IC封装测试业展望

三、2011年IC材料和设备行业展望

第三节 芯片设计行业发展趋势分析

一、技术发展趋势分析

二、产品发展趋势分析

三、行业竞争格局展望

第四节 2011-2015年中国芯片设计市场趋势分析

一、2010-2011年芯片设计市场趋势总结

二、2011-2015年芯片设计发展趋势分析

三、2011-2015年芯片设计市场发展空间

四、2011-2015年芯片设计产业政策趋向

五、2011-2015年芯片设计技术革新趋势

六、2011-2015年芯片设计价格走势分析

七、2011-2015年国际环境对行业的影响

第十三章 未来芯片设计行业发展预测

第一节 2011-2015年国际芯片设计市场预测

- 一、2011-2015年全球芯片设计行业产值预测
- 二、2011-2015年全球芯片设计市场需求前景
- 三、2011-2015年全球芯片设计市场价格预测

第二节 2011-2015年国内芯片设计市场预测

- 一、2011-2015年国内芯片设计行业产值预测
- 二、2011-2015年国内芯片设计市场需求前景
- 三、2011-2015年国内芯片设计市场价格预测
- 四、2011-2015年国内芯片设计行业集中度预测

第十四章 芯片设计行业投资现状分析

第一节 2010年芯片设计行业投资情况分析

- 一、2010年总体投资及结构
- 二、2010年投资规模情况
- 三、2010年投资增速情况
- 四、2010年分行业投资分析
- 五、2010年分地区投资分析
- 六、2010年外商投资情况

第二节 2011年1季度芯片设计行业投资情况分析

- 一、2011年1季度总体投资及结构
- 二、2011年1季度投资规模情况
- 三、2011年1季度投资增速情况
- 四、2011年1季度分行业投资分析
- 五、2011年1季度分地区投资分析
- 六、2011年1季度外商投资情况

第十五章 芯片设计行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

- 一、2010-2011年我国宏观经济运行情况
- 二、2011-2015年我国宏观经济形势分析
- 三、2011-2015年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

- 一、2011年芯片设计行业政策环境

二、2011年国内宏观政策对其影响

三、2011年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2011年社会环境发展分析

三、2011-2015年社会环境对行业的影响分析

第四节 电子信息产业振兴规划

一、电子信息产业振兴规划概述

二、电子信息产业振兴规划细则

三、电子信息产业振兴规划三大任务

四、电子信息产业振兴规划六大工程

五、电子信息产业振兴规划十项措施

六、电子信息产业振兴规划的意义与作用

七、电子信息产业振兴规划对芯片设计行业的影响

第十六章 芯片设计行业投资机会与风险

第一节 2011-2015年行业投资机会分析

一、台湾放行四家芯片商投资大陆

二、半导体芯片产业或成投资热点

三、应用芯片研究前景广阔

四、生物芯片投资时刻到来

第二节 芯片设计行业投资效益分析

一、2010-2011年芯片设计行业投资状况分析

二、2011-2015年芯片设计行业投资效益分析

三、2011-2015年芯片设计行业投资趋势预测

四、2011-2015年芯片设计行业的投资方向

五、2011-2015年芯片设计行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响芯片设计行业发展的主要因素

一、2011-2015年影响芯片设计行业运行的有利因素分析

二、2011-2015年影响芯片设计行业运行的稳定因素分析

三、2011-2015年影响芯片设计行业运行的不利因素分析

四、2011-2015年我国芯片设计行业发展面临的挑战分析

五、2011-2015年我国芯片设计行业发展面临的机遇分析

第四节 芯片设计行业投资风险及控制策略分析

一、2011-2015年芯片设计行业市场风险及控制策略

二、2011-2015年芯片设计行业政策风险及控制策略

三、2011-2015年芯片设计行业经营风险及控制策略

四、2011-2015年芯片设计行业技术风险及控制策略

五、2011-2015年芯片设计同业竞争风险及控制策略

六、2011-2015年芯片设计行业其他风险及控制策略

第十七章 芯片设计行业投资战略研究

第一节 芯片设计行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国芯片设计品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、芯片设计实施品牌战略的意义

三、芯片设计企业品牌的现状分析

四、我国芯片设计企业的品牌战略

五、芯片设计品牌战略管理的策略

第三节 芯片设计产业发展策略

一、芯片设计后续项目谈判策略

二、芯片设计企业发展策略分析

三、我国芯片设计产业提高全球交付能力策略

四、中国芯片设计业发展策略

第四节 芯片设计行业投资战略研究

一、2011年电子产业行业投资战略

二、2011年芯片设计行业投资战略

三、2011-2015年芯片设计行业投资战略

四、2011-2015年细分行业投资战略

图表目录

图表：芯片设计产业的价值链

图表：芯片设计产业与其他产业的关系

图表：芯片设计产业链结构图

图表：2003-2010年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表：2010年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表：2010年中国集成电路产业各价值链结构

图表：全球IC设计产业产值发展趋势

图表：IC设计产业成长优于全球IC产业成长

图表：2009年全球半导体电子设备设计国家排名

图表：全球IC设计产业布局

图表：全球IC设计产业概况

图表：2009年台湾地区前十大设计公司

图表：台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势

图表：2002-2010年台湾主要无晶圆厂IC设计公司营收走势

图表：2004-2010年台湾主要电源IC设计公司营收走势

图表：2001-2010年间国内生产总值增长趋势

图表：2005Q1-2010Q4年各季度国内生产总值走势

图表：2003-2010年工业增加值及增长速度

图表：2010年主要工业产品产量及其增长速度

图表：2010年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度

图表：2003-2010年固定资产投资增长情况

图表：2001-2010年中国投资率和消费率变化情况

图表：我国有线电视向数字化过渡时间表

图表：低功率芯片技术实现

图表：微笑曲线

图表：2009年中国前十大IC设计业者排名

图表：2002-2010年IC设计业销售收入

图表：2005-2010年我国芯片设计业经济指标

图表：我国IC设计业的SWOT分析

图表：西部地区一些IC设计公司

图表：2010年中国电源管理芯片市场品牌结构

图表：DLP工作原理

图表：使用DLP技术的厂商一览

图表：LCOS面板结构图

图表：2010年我国主要宏观经济指标增长的市场预测

图表：中国集成电路产业规模和增长速度

图表：2010-2015年中国集成电路产业规模预测

图表：2010-2015年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2010-2011年我国IC销售额预测

图表：中国IC市场应用结构及自给能力

图表：2006-2010年华虹集团经营动态

图表：中芯国际技术文件的支持

图表：2010年全球10大半导体供应商的初步排名

图表：iSuppli按公司总部所在地对全球半导体销售额进行的初步估计

图表：软硬件协同设计流程

图表：软硬件协同设计流程

图表：设计人员正在使用电压岛、电源门控和其他功率控制技巧

图表：1999~2006年我国集成电路芯片产量变动轨迹

图表：1999~2006年集成电路及芯片产量变动轨迹

图表：2009年中国市场NVIDIA与ATI新品关注比例对比

图表：2010年中国市场最受关注的前十大显示芯片

图表：2005年中国手机基带芯片市场份额分布

图表：2010年大唐微电子技术公司主营构成

图表：2010年大唐微电子技术公司每股收益指标

图表：2010年大唐微电子技术公司获利能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司经营能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司偿债能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司资本构成指标

图表：2010年大唐微电子技术公司发展能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司现金流量指标

图表：2010年中芯国际综合损益表

图表：2010年中芯国际资产负债表

图表：2010年中芯国际现金流量表

图表：:2010年中芯国际业务构成

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司主营构成

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司获利能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2003-2010年电信综合价格水平

图表：2003-2010年电话用户到达数和新增数

图表：2003-2010年移动电话用户所占比重

图表：2005-2010年移动电话用户各月净增比较

图表：2004年以来各月移动分组数据用户发展情况

图表：2005-2010年固定电话用户各月净增比较

图表：2003-2010年无线市话用户所占比重

图表：2003-2010年公用、办公、住宅电话用户所占比重

图表：2003-2010年网民数和互联网普及率

图表：2004年以来各月互联网拨号、宽带接入用户净增比较

图表：2003-2010年固定本地电话通话

图表：2003-2010年移动本地电话通话时长

图表：2010年长途电话通话时长

图表：2003-2010年长途电话市场构成

图表：2006-2010年IP电话发起方式

图表：2004-2010年短信业务发展情况

图表：2002-2010年我国汽车产量变化趋势图

图表：1994-2010年中国汽车行业销量

图表：2001-2010年汽车零部件行业利润变化

图表：2001-2010年整车行业库存水平变化

图表：2005-2011年汽车销量预测

图表：2001-2010年我国手机产量变化趋势图

图表：2010年手机品牌的市场份额

图表：2010年正货、水货和二手手机的市场份额

图表：2009-2010年的重点机型

图表：2010-2015年中国集成电路产业规模预测

图表：2010-2015年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2010年中国芯片制造业前十大企业销售额

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201106/70218.html>